

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

假設每股[編纂]為[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的中位數），並假設在扣除[編纂]費用、[編纂]以及我們應付與[編纂]有關的其他估計費用後，我們將從[編纂]中獲得約[編纂]港元的[編纂]淨額。我們計劃將[編纂]的[編纂]淨額用作以下用途：

約[編纂]%（或[編纂]港元）的[編纂]淨額將用於支持我們昆山、黃石及金壇等生產基地的產能擴張。我們計劃逐步提升產能，專注於高端PCB產品的產能作未來應用。我們擬通過節能減排與資源循環利用技術升級，加強可持續的製造體系。具體而言：

- 約[編纂]%（或[編纂]港元）的[編纂]淨額將被分配用於數據通訊領域相關產能建設，以把握數據中心等應用場景需求增長帶來的發展機遇。

我們計劃擴充產能，以回應下游需求變化及PCB行業產品要求的演變。全球PCB行業的市場規模預計於2030年達至1,233億美元，2025年至2030年的複合年增長率為7.7%。增長主要由技術要求較高的應用領域推動。完成後，我們預計數據通訊領域的PCB有效年產能將增加約0.9百萬平方米。我們的計劃產能擴充旨在支持：(i)生產18層以上的高層數多層PCB、高性能及高頻PCB；(ii)工藝及技術升級，以提升產出效率、一致性及自動化水平；及(iii)透過優化佈局及配置提升生產效率。上述目標無法透過我們現有設施增量利用即可完全達成。具體而言，計劃產能擴充將有助於(i)提高設備精度及檢測能力，升級背鑽設備及檢測設備，實現0-4密耳的殘樁長度控制精度；(ii)產線配置方面，支持高達30-35:1的更高縱橫比；及(iii)厚板兼容性方面，兼容下一代8-10毫米的板厚規格。此外，現有生產線接近滿負荷運轉，截至2026年3月31日止三個月的利用率達到99.1%，導致擴增空間有限。據中國法律顧問的意見，擴產項目須按照中國法律及法規取得監管批文及辦理備案，包括但不限於向國家發改委地方主管部門提交項目備案、取得建築工程規劃許可證、建築許可證、環境影響評估、消防安全批准及竣工驗收。我們的中國法律顧問認為，根據現行中國法律，概無阻礙我們取得必要批文或執照的法律障礙，前提是所有適用規定均已妥為遵守，及現行政策、法規、地方政府監管及執法規定並無重大變動。

未來計劃及[編纂]用途

因此，擴充產能乃必要措施，以使製造能力與市場需求相配合，並提升滿足客戶技術要求下規格的能力，支持市場滲透，同時提升產能利用率。

- i. 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額計劃用於相關設備採購及升級。下表載列我們計劃採購或升級的生產設備詳情：

相關生產過程	估計 採購設備數量	估計 單價範圍
		人民幣千元
鑽孔	1,000-1,200	~400-4,750
層壓	200-350	~60-77,800
電鍍	50-150	~850-34,580
內層成像與蝕刻	150-200	~750-8,500
電氣測試	100-150	~300-15,900
其他 ⁽¹⁾	150-200	~350-7,350

附註：

- (1) 其他包括對應外形銑切、填充通孔、內層AOI和外層乾膜等生產過程的設備。

- ii. 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額分配予：(a)土地及廠房；及(b)配套設施。

我們計劃加強與核心設備供應商的合作以優化設備的性能；增加對數字化管理系統和AI技術的投入，以優化生產效率並提升污染防治與資源循環利用能力。

- o 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額將被分配用於智能汽車領域相關產能建設，滿足汽車電動化、智能化及網聯化趨勢帶來的增長需求。完成後，我們預期智能汽車行業PCB的實際產能每年將增加約0.2百萬平方米。具體而言：

- i. 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額計劃用於相關設備採購及升級。下表載列我們計劃採購或升級的生產設備詳情：

相關生產過程	估計 採購設備數量	估計 單價範圍
		人民幣千元
層壓	1-10	~850-76,000
鑽孔	60-100	~329-6,000
電鍍	1-30	~700-10,000
電氣測試	1-20	~300-6,000
外形銑切	10-30	~800-5,270
其他 ⁽¹⁾	1-10	~200-2,800

附註：

- (1) 其他包括對應化學鍍金、文字印刷、內層成像與蝕刻等生產過程的設備。

未來計劃及[編纂]用途

- ii. 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額分配予：(a)土地及廠房；及(b)配套設施。

我們計劃提升智能駕駛輔助系統、智能座艙、功率半導體嵌入式PCB及三電系統等車規級高端PCB產能。我們計劃升級生產設備，提升精度、一致性及可靠性，並提升生產效率與良率。我們將加強環保措施，提升綠色智造能力。

約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額將用於數據通訊及智能汽車領域高性能PCB研發及技術創新。具體而言：

- o 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額將用於強化數據通訊領域的高性能PCB研發，涵蓋研發人員費用、材料與測試成本。我們重點投入CoWoP(chip-on-wafer-on-PCB)等技術的研究與mSAP等先進工藝的創新，並推動共封裝光學元件等次世代技術，以強化訊號傳輸、電力輸送及功能整合的表現。我們亦將投資用於下一代AI服務器及3.2T高速網絡交換機的高端PCB產品技術，持續推進448 Gbps及以上速率高速信號傳輸相關技術研發。我們旨在提升產品的高密、高頻高速及高通流性能。研發人員開支涵蓋我們現有數據通訊研發團隊的持續員工成本及薪資調漲，以及於2026年及2027年新聘約400至500名研發人員的費用，相關人員包括五至10名產品開發經理、30至45名信號完整性及材料工程師、120至140名工程設計工程師、150至180名工藝及技術工程師、55至75名測試工程師及40至50名助理工程師。該等新聘人員預期將具備PCB工程、電子工程或相關學科的經驗及資格，其中聘用的中高層人員預期須具備至少八年行業經驗。數據通訊研發團隊新聘人員的預期平均年薪介乎人民幣200,000元至人民幣300,000元。
- o 約[編纂]%(或[編纂]港元)的[編纂]淨額將用於加大智能汽車的高性能PCB研發及基礎性研究投入，涵蓋相關研發人員費用及研發活動費用。

智能汽車方面，我們聚焦汽車電動化、智能化及網聯化的趨勢，提升車規級PCB產品的高壓、電氣性能、材料穩定性及熱管理屬性。我們推動功率半導體嵌入式PCB技術在主驅逆變器等汽車部件的應用，並優化高壓平台技術、驗證替代材料以及增強銀燒結制樣能力。基礎性研究方面，我們專注於技術，包括高多層板堆

未來計劃及[編纂]用途

疊架構、高頻高速材料選型及特性優化、HDI技術可靠性以及高通流載電能力。研發人員開支涵蓋現有研發團隊的員工成本及薪資調漲，以及於2026年及2027年新聘約60至90名研發人員的費用，相關人員包括約一至五名研發經理、10至15名研發工程師、10至15名設計工程師、15至25名工藝工程師、六至10名測試工程師及18至20名助理工程師。新聘人員預期將具備汽車PCB工程、電氣工程或相關學科的經驗及資格，其中聘用的中高層人員預期須具備至少八年行業經驗。智能汽車研發團隊新聘人員的預期平均年薪為人民幣200,000元至人民幣300,000元。請參閱「一[編纂]用途一[編纂]用途時間表」。我們計劃動用內部現金資源及營運現金流量，以彌補支出中未被分配[編纂]用途淨額所涵蓋的部分。

約[編纂]% (或[編纂]港元) 的[編纂]淨額將用於戰略性投資併購。

我們將聚焦對PCB產業鏈的目標企業進行投資及／或收購，該等目標企業主要包括：(i)具備互補性先進生產技術的PCB製造商；(ii)具備互補性銷售網絡及地域覆蓋的PCB製造商；及(iii)其他對我們的技術開發和業務營運有利的公司，包括但不限於擁有本集團目前尚未具備的專有製造工藝或材料技術的公司；以及擁有能夠拓展我們可觸及市場的渠道或客戶關係的公司。我們將探索具備技術優勢的海外企業，特別是存在業務分拆出售機會的目標。我們將依託自身產業經驗，在全球範圍內物色目標。於評估潛在投資或收購目標時，我們將考慮(其中包括)目標公司以下準則：(i)主要業務及其與我們的策略及營運方面的協同效應，特別是能加強我們專注於高增值PCB產品的目標公司；(ii)營運規模：(a)針對通常涉及商業化前實體的投資目標，重點主要在於技術及協同潛力，且並無最低收入門檻，及(b)針對收購目標，優先考慮年收入不低於100百萬美元的公司；(iii)財務狀況，包括盈利能力及財務穩健性；(iv)管理團隊於PCB行業或相關領域的往績；(v)內部控制、風險管理框架及合規紀錄。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的投資或收購目標。

約[編纂]% (或[編纂]港元) 的[編纂]淨額將用於營運資金及一般公司用途。

倘[編纂][編纂]淨額多於或少於預期(包括因(i)[編纂]設定高於或低於[編纂]範圍的中位數；或(ii)行使[編纂]的額外[編纂]淨額)，我們將按比例調整[編纂]淨額的分配以用作上述用途。若我們發展計劃的任何部分無法按計劃實施(例如因政府政策變化導致我方項目開發受阻，或發生不可抗力事件)，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]的[編纂]淨額。

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]用途時間表

我們擬根據下文所載時間表使用[編纂]淨額，惟時間表可因我們的實際需要及屆時的市場情況而作出變動。

	將用[編纂]淨額					總計
	[編纂] 淨額總額的 百分比 (%)	2026年	2027年	2028年	2029年 (以百萬港元計)	2030年
支持我們生產基地的產能擴張	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
數據通訊領域相關產能建設	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
相關設備採購及升級	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
土地及廠房建築及配套设施	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
智能汽車領域相關產能建設	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
相關設備採購及升級	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
土地及廠房建築及配套设施	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
數據通訊及智能汽車領域高性能PCB研發及技術創新	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
數據通訊領域高性能PCB研發	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
智能汽車的高性能PCB研發及基礎性研究投入	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
戰略性投資及收購 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及一般公司用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 戰略性投資及收購的資金分配將根據我們的具體投資及收購計劃決定。

倘[編纂]淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，以及在相關法律及法規准許的情況下，我們僅會將該[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。